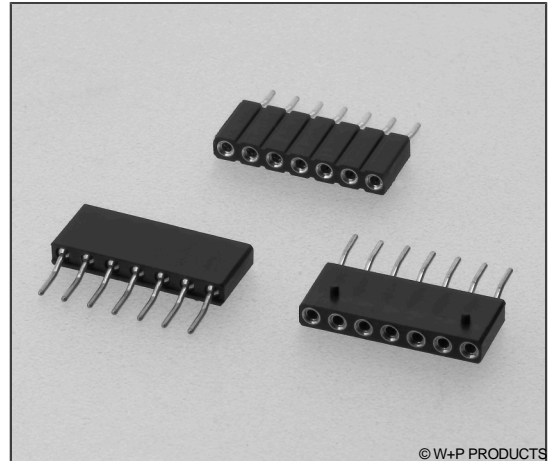


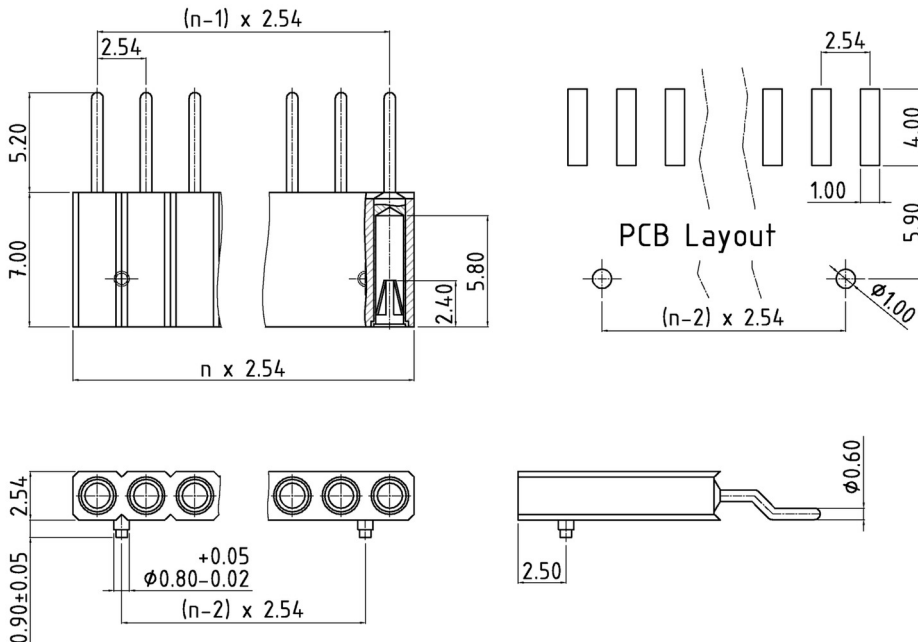
## SMT-Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, liegend, 1-reihig SMT Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Horizontal, Single Row

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.  
Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins. Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



Series	Contacts*	Rows	Sleeve Plating	Clip Plating*	Loc. Pegs*	Packaging*	Body (opt.)*	Leadfree (opt.)
<b>1533</b>	<b>007</b> 003-050	<b>1</b>	<b>50</b> 50 Hülse verzinkt <i>Tin plated sleeve</i>	<b>00</b> 00 Feder vergoldet <i>Gold plated clip</i> 10 0,25µm Au (Option) 0.25µm Au (Option) 30 0,75µm Au 0.75µm Au 50 Feder verzinkt <i>Tin plated clip</i>	<b>00</b> 00 Ohne Pos. hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen (auf Anfrage) <i>With loc. pegs</i> (on request)	<b>ST</b> TR (Option)	<b>F</b> [ ] Gerillt <i>Grooved</i> F Glatt <i>Flat</i>	<b>LF21</b> LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c <i>On request leadfree without RoHS exemption 6c</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
**TR (Option)** Tape & Reel Verpackung / *Tape & Reel packaging*

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

